

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2023-011

天水华天科技股份有限公司 关于全资子公司项目投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2023年3月26日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司实施“高密度高可靠性先进封测研发及产业化”项目的议案》，同意全资子公司华天科技（江苏）有限公司（以下简称“华天江苏”）投资28.58亿元进行“高密度高可靠性先进封测研发及产业化”项目的建设。

本次投资属公司董事会审批权限，不需经过股东大会批准。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

- 1、项目名称：高密度高可靠性先进封测研发及产业化
 - 2、项目建议单位：华天科技（江苏）有限公司
 - 3、项目建设地点：江苏省南京市浦口经济开发区
 - 4、项目内容：新建厂房及配套设施约17万m²，购置主要生产工艺设备仪器476台（套）。项目建成投产后形成Bumping 84万片、WLCSP 48万片、超高密度扇出UHDFO 2.6万片的晶圆级集成电路年封测能力。
 - 5、项目投资估算：项目总投资285,800.00万元，其中建设投资276,516.80万元，建设期利息1,265.60万元，铺底流动资金8,017.60万元。
 - 6、项目实施资金来源：华天江苏股东出资及华天江苏向银行贷款。
- 华天江苏目前注册资本9.5亿元，后续公司将根据华天江苏经营发展及项目建设需要履行相关投资决策程序后，对其增加投资。

7、项目建设期：项目建设期为 5 年，2023 年 6 月至 2028 年 6 月。项目采用边建设边生产的方式进行。

8、项目预计达到的效益：预计达产后年实现营业收入 126,072 万元，实现净利润 26,627 万元。

9、可行性分析及前景

后摩尔时代，先进封装属于必然选择。随着晶圆工艺制程逐步进入到物理极限，摩尔定律进程放缓，成本快速增长，以倒装、扇入/扇外型封装以及晶圆级、系统级封装为主的先进封装以其低成本、高性能等优势将重新定义封装产业链地位。根据分析机构 Yole 的数据，2021 年全球先进封装市场规模约 350 亿美元，到 2025 年先进封装的全球市场规模约 420 亿美元，先进封装在全部封装的占比从 2021 年的 45% 增长到 2025 年的 49.4%，2019-2025 年全球先进封装市场的 CAGR 约 8%，相比同期整体封装市场和传统封装市场，先进封装市场的增长更为显著，将为全球封装市场贡献主要增量。在产量方面，2019 年全球先进封装产量为 2891.4 万片（折合成 12 吋晶圆），预计到 2025 年先进封装产品产量达到 4330 万片（折合成 12 吋晶圆），市场前景十分广阔。

根据国内外市场需求情况和国际封装技术发展趋势，本项目主要定位于市场需求量大、应用前景好的凸点封装、晶圆级封装、超高密度扇出封装，项目产品主要为 Bumping、WLCSP、UHDF0 等，应用于 5G、物联网、智能手机、平板电脑、可穿戴设备、医疗电子、安防监控以及汽车电子等战略性新兴产业。

项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《国家集成电路产业发展推进纲要》、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订）等国家相关产业政策。

三、项目建设单位基本情况

名称：华天科技（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320111MA27EJ3N21

住所：南京市浦口区浦口经济开发区步月路 9 号—190

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：肖智轶

注册资本：95000 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 16 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；电子元器件零售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：华天科技（西安）投资控股有限公司持有华天江苏 100% 股权。公司持有华天科技（西安）投资控股有限公司 76.43% 股权，公司全资子公司华天科技（西安）有限公司持有华天科技（西安）投资控股有限公司 23.57% 股权。因此，公司间接持有华天江苏 100% 股权。

华天江苏成立于 2021 年 11 月，截至 2022 年 12 月 31 日，华天江苏总资产 201,505,930.25 元，净资产 199,990,606.07 元，暂无营业收入。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目投资的目的

华天江苏为公司根据战略规划和经营发展需要，在南京市浦口区设立晶圆级先进封装测试产业基地，由华天江苏承担建设“高密度高可靠性先进封测研发及产业化”项目。项目的实施能够提高公司晶圆级先进封装测试技术水平和生产能力，增强公司核心竞争力，从而进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，实现公司持续稳定发展。

2、存在的风险

本项目建设投资是基于行业市场前景和集成电路封装测试技术发展趋势的判断而实施的，集成电路封装测试技术发展趋势和产品市场需求变化以及经营团队的业务管理能力给项目的实施带来一定的不确定性，因而对项目未来经济效益的实现也带来一定的不确定性。

3、对公司的影响

本项目建设期五年，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。项目建成投产后，将会进一步扩大公司先进封装测试产能规模，提高公司综合竞争力。

五、备查文件：

公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日